PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

57-026163

(43) Date of publication of application: 12.02.1982

(51)Int.Cl.

C23C 13/12 C23C 15/00 H01L 21/285

(21)Application number: 55-099956

(71)Applicant: HITACHI LTD

(22)Date of filing:

23.07.1980

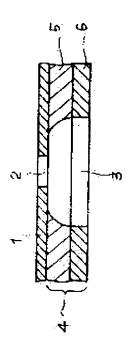
(72)Inventor: TANAKA MINORU

KUBOTA HITOSHI AIUCHI SUSUMU

(54) MASK FOR FORMING THIN FILM AND ITS MANUFACTURE

(57)Abstract:

PURPOSE: To form a fine pattern shape of high accuracy by making the hole of the pattern in a sheet and unitedly combining the sheet with a reinforcing material having a plywood structure obtd. by laminating 2 or several sheets of different materials for reinforcement at a part of the sheet except the hole and its periphery. CONSTITUTION: A mask for forming a thin film is composed of a sheet 1 having the hole of a pattern and a reinforcing material 4 having a plywood structure obtd. by laminating 2 sheets 5, 6 of different materials for reinforcement. The sheet 1 and the material 4 are unitedly combined with each other at a part of the sheet 1 except the hole 2 and its periphery. To manufacture the mask the sheets 5, 6 obtd. by vapor deposition. sputtering or other method are laminated and united, and on one side of the resulting reinforcing material 4 the sheet 1 is formed by vapor deposition, sputtering or other method. The hole 2 and a part of the opening 3 are then made with an etching soln., and the opening 3 of the sheet 6 is further removed by etching.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision

⑩公開特許公報(A)

昭37-26163

⑤ Int. Cl.³C 23 C 13/12 15/00

H 01 L 21/285

識別記号 105 104 庁内整理番号 7537—4K 7537—4K 7638—5F ◎公開 昭和57年(1982)2月12日

発明の数 2 審査請求 未請求

(全 4 頁)

砂薄膜形成用マスクおよびその製造方法

②特 願 昭

願 昭55—99956

御出

願 昭55(1980)7月23日

⑩発 明 者 田中稔

横浜市戸塚区吉田町292番地株 式会社日立製作所生産技術研究

所内

@発 明 者 窪田仁志

横浜市戸塚区吉田町292番地株

式会社日立製作所生產技術研究 所内

⑩発 明 者 相内進

横浜市戸塚区吉田町292番地株 式会社日立製作所生産技術研究 所内

⑪出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区丸の内1丁目5

番1号

個代 理 人 弁理士 薄田利幸

明細

1 発明の名称 薄膜形成用マスクシよびその製造方法

2. 特許請求の範囲

- 1. 薄板にパターンの孔を設け、前記薄板の孔 部及びその周辺を除いた部分に前記薄板と同 じ材質の補強用薄板と、1 ないし数種類の異 なる材質の補強用薄板とを積層して成る合板 構造の補強材を前記薄板と一体的に設けたこ とを特徴とする薄膜形成用マスク。
- 2. 薄板とは材質が異なり、かつお互いに材質 の異なる2 ないし数種類の補強用薄板を積層 して成る特許請求の範囲第1項配載の薄膜形 成用マスク。
- 3. バターンの孔が周期的に繰り返された特許 請求の範囲第1項もしくは第2項記載の薄膜 形成用マスク。
- 4. 存板と、少なくとも一種類の補強用存板と は特定のエッチングに対してエッチング速度 が異なる材質である特許請求の範囲第1項な

いし第 5 項のいずれかに記載の薄膜形成用マスク。

- 5. 合板構造の補強材の片面上にパターン孔を 設ける薄板を形成し、前記補強材の一部をエッチングにより取り除き、補強材が取り除か れた部分の前記薄板の中央部にパターンの孔 を設けることを特徴とする薄膜形成用マスク の製造方法。
- 4 補強材のパターンを設ける薄板のない片面上にレジストパターンを設けてエッチングを行うことにより、前配補強材の一部を取り除くことを特徴とする特許請求の範囲第5項配載の薄膜形成用マスクの製造方法。
- 7. 補強材のパターンを設ける薄板のない片面上に金属マスクで被覆して前記補強材の解出 部を酸化膜で被い、金属マスクを溶解除去した後、前記補強材の酸化膜で被われていない 部分をエッチングにより取り除くことを特徴 とする特許請求の範囲第5項記載の薄膜形成用マスクの製造方法。

- 8 薄板の補強材のない側にレジストパターンを設けてエッチングを行うことにより、補強材を取り除いた部分の中央部にパターンの孔を設けたことを特徴とする特許請求の範囲第5項記載の薄膜形成用マスクの製造方法。
- 9. 薄板の補強材を取り除いた部分の中央部に レーザ加工によりパターンの孔を設けたこと を特徴とする特許請求の範囲第5項記載の薄 験形成用マスクの製造方法。
- 10. 薄板の補強材を取り除いた部分の中央部に電子ビーム加工によりパターンの孔を設けたことを特徴とする特許請求の範囲第5項記載の薄膜形成用マスクの製造方法。

5. 発明の詳細な説明

7

本発明は蒸着、又はスパッタリング等の薄膜形成技術により、所定の薄膜パターンを基板に付着させる際に使用する薄膜形成用マスクかよびその製造方法に関するものである。

蒸着又は、スパッタリング等の薄膜形成技術 により所定の形状をした薄膜パターンを基板表

くするととは強度的に困難であり、また薄くする程マスクに挽みが生じ形状や寸法が狂ってくる。

しかし、蒸着やスパッタリングでマスクを介して所定のパターン形状を形成しようとする場合、加熱粒子の衝突によりマスク温度は自然に上昇する。更に、薄膜の基板への付着強度を上げるため基板を 300c~400cに加熱して薄膜を形成すればマスクもその影響を受けて数百度 Cに

面に付着させる場合、所定の孔形状を有する板 状のマスクを用いる。

従来、この所定形状の孔を有するマスクとし ては、金属板をブレス加工あるいはフェトエッ チング技術を用いて腐食抜き加工したものが一 般的に用いられている。しかしプレス加工では 番組でかつ複雑な 孔形状の加工はほとんど不可 能であり、一方金属板の腐食抜き加工ではプレ ス加工に比較した場合、複雑を孔形状の加工は 容易であるが、眩孔形状の寸法精度は一般には 眩金属板板厚の土10%程度であり、例えば0.1 mm の板厚の金銭板を用いた場合の寸法精度は土 10 mm 程度となるため、 数細でかつ高度なパター ン合わせ精度の要求に十分応えることはできな かった。又とのような金属板を腐食抜き加工し た場合の孔形状の最小寸法は一般に該金属板の 板厚と同程度であり板厚より小さい寸法のパタ - ン孔をあけることはほとんど不可能である。 従って数細パターンを形成するにはマスクを薄 くしなければならない。しかし単にマスクを薄

加熱されることもある。とのよりな場合第1図に示すよりな二枚構造のマスクにおいては、薄板1と補強材4とは材質が異なるため、それぞれの熱膨張係数の違いにより、薄板1に設けたパターンの孔2の寸法や形状が変化したり、マスク自体にそりが生ずるといり新たな実用上の問題が生じる。

本発明の目的は、微細かつ高精度のパターン形状が加工でき、強度的に強く、熱変形も比較的少なく実用上の使用に耐える新規な薄膜形成用マスクとその製造方法を提供するにある。

本発明は、薄板にバターンの孔を散け、前記薄板の孔部及びその周辺を除いた部分に、互いに材質の異なる2種類の補強用薄板を交互に積層してなる合板構造の補強材を一体的に設けたとを特徴とする。さらに本発明は、補強材の一部をエッチングにより取り除き、補強材が取り除かれた部分のベターン形成用薄板の中央部にバターンの孔を設けることを特徴とする。

以下本発明を第2図乃至第3図に示す実施例

に従って具体的に説明する。

第2回は本発明による薄膜形成用マスクの断 面図を示すもので補強材部分が二層構造の例で ある。図において薄板1にパターンの孔2が設 けられており、薄板!にはそれど一体的に構成 されている補強材 4 が設けられ、補強材の前記 薄板1のパターン孔部2およびその周辺は取り 除かれて開口部ろとなっている。補強材4は補 強用薄板 5,6 により一体的に構成され合板構造 となっている。補強用薄板5は、薄板1とは選 択エッチンが可能なように材質が異なっている。 補強用薄板6は、補強用薄板5とは材質が異な っているが、薄板!とは材質が同じでも、異な っていてもかまわない。又、補強材4を構成す る補強用薄板 5.6の積層数は二層に限定するも のではない。薄板1および補強材4の厚さは、 パターン孔2の寸法、精度、マスクの大きさ、 マスクの取扱い条件等種々の要因によって決定 される。

次にとのような薄膜形成用マスクの製造方法

をあける。次に前記エッチング液とは異なる補 強用薄板 5 に対して最もエッチング速度が大き く薄板 1 、補強用薄板 6 、フォトレジストに対 してエッチング速度の小さいエッチング液によ り補強用薄板 6 の部分の開口部 3 をエッチング 除去する。

又、前述した方法とは異なる別のマスク製造方法として薄板1の表面をフォトレジストにより全面マスキングして補強材質から順次補強用 薄板をエッチング除去して、第口部3をあけた 後、最後に開口部3の薄板1の中央部にエッチ ング、レーザ加工、電子ピーム加工等の技術に よりパターンの孔を設けることもできる。

又、逆に薄板1にパターンの孔2を先に加工して、後から補強材4に開口部3をあけるとともできる。との場合も必要があればパターン孔2を加工した後、薄板1の表面に全面フォトレジストを塗布してマスキングし、次に開口部3をあけてもよい。

補強材 4 に開口部 3 を設ける他の方法として補

について説明する。

蒸着やスパッタリング、メッキ等の薄膜形成技術、薄板の圧接技術、あるいは両者の組合せ技術によって得られた補強用薄板 5.6 を積層一体化した合板構造の補強材 4 の片面に、薄板 1 を形成する。薄板 1 の形成は、蒸着、スパッタリング、気相成長、液相成長、メッキ等のいずれについても可能である。エッチングによりパターン孔を形成する方法について説明する。

第2図に示すよりな補強材4が二層構造で、 しかも薄板1と補強用薄板6とが同じ材質の場合、まずマスクの両にフォトレジストを強強 し、露光、現像によって薄板1側には所定のパクーン形状を、補強用薄板6個にはのーンとあるいとなる。次に薄板1、かつ前配パターンとあるのでは、かりかり、補強用薄板6に対して表して、かりが多っとの孔2、かよび開口部3の一部

強材の表面に前述のレジストパターンの代りに 酸化膜パターンを形成し、エッチングを行う方 法もある。

今までは、1個のパターン孔についてのみ述べてきたが、実際に薄膜パターンを形成する場合、生産効率を考慮し、1枚のマスクに多数のパターンを設けるととが多い。第3回は、 とのような場合の実施例である。繰返し周期・はレジスト腺の精度あるいはレーザ加工、 電子マム加工の精度によって決まる。又、1枚のマスク内のパターン孔形状は全てを同形状にしてもよいし、目的によっては数種類の形状を含むとも可能である。

以上述べたように本発明によれば、薄板にパターンの孔を設け、前記薄板の孔部及びその周辺を除いた部分に互いに材質の異なる 2 ないし数種類の補強用薄板を適当な組合せにより積層してなる合板構造の補強材を一体的に設けたので、数細かつ高精度のパターン形状が加工でき、強度的に強く、熱変形も比較的小さくてすむ薄

膜形成用マスクを提供するととができ、本マス クを使用することにより高精度数細寸法のパタ ーン膜を作成することができる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は従来の実施例を示す断面図、第2図は本発明の実施例を示す断面図、第3図は繰返し周期4で加工されたマスクの他の実施例を示す断面図である。

1 … 釋板

1. .

- 2 … パターンの孔
- 3 … 開口部
- 4 … 補強材
- 5,6 …補強用薄板

